

嵌入式系统软/硬件协同设计技术综述

熊光泽,詹瑾瑜

电子科技大学 计算机科学与工程学院, 四川 成都 610054

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 随着微电子技术和计算机技术的飞速发展, 嵌入式产品广泛应用于消费电子、智能家电、通信设备等多个领域。介绍了嵌入式系统现状, 分析了今后的发展趋势, 阐述了传统方法的缺陷, 介绍了一个新的设计方法学——SoC(片上系统)嵌入式系统软/硬件协同设计, 并较详细分析了支撑该方法学的相关技术。

关键词 [嵌入式系统](#); [协同设计](#); [重用](#); [片上系统](#); [IP核](#); [软件构件](#); [协同综合](#); [测试调度](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [专题](#)

通讯作者:

gzxiong@uestc.edu.cn

作者个人主页: [熊光泽,詹瑾瑜](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(1078KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“嵌入式系统; 协同设计; 重用; 片上系统; IP核; 软件构件; 协同综合; 测试调度”的相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [熊光泽](#)

· [詹瑾瑜](#)